

## **合肥晶合集成电路股份有限公司**

### **关于新产品研发进展的自愿性披露公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **重要内容提示：**

合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）发布汽车电子芯片研发进展，公司 110nm 面板驱动芯片（DDIC）已于近期完成汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试。为便于广大投资者了解晶合集成针对汽车电子芯片的研发进展情况，现将新产品进展情况披露如下：

#### **一、新产品基本情况**

车用 110nm 显示驱动芯片（DDIC）基于已量产的消费型 110nm 显示驱动平台为基础开发，通过更严格的制程、品质管控提升组件稳定度，同时微缩后段金属层加快组件速度，以满足车载规格需求。目前该产品在车规 CP 测试良率已达到良好标准，并已于 2023 年 3 月完成 AEC-Q100 车规级认证，于 2023 年 5 月已通过公司客户的汽车 12.8 英寸显示屏总成可靠性测试。

#### **二、新产品研发对公司的影响**

随着国内新能源汽车的市场占有率逐步提升，汽车电子国产化进程持续推进，公司已通过 110nm 显示驱动芯片（DDIC）代工产品成功进入汽车电子领域，具备进一步布局汽车电子领域的生产、技术条件，并将进一步丰富公司产品结构，助力公司持续稳定发展。

#### **三、相关风险提示**

由于汽车芯片从导入到正式装车所需时间较长，从完成产品测试至大批量出货仍需一定的周期和验证流程，存在市场不确定性，未来可能面临市场需求低于预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

特此公告。

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会

2023年5月22日